

<<微电子器件封装>>

图书基本信息

书名：<<微电子器件封装>>

13位ISBN编号：9787502590376

10位ISBN编号：7502590374

出版时间：2006-8

出版时间：化学工业出版社

作者：周良知

页数：163

字数：261000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微电子器件封装>>

内容概要

本书较详细地介绍了微电子器件封装用的高分子材料、陶瓷材料、金属焊接材料、密封材料及黏合剂等材料，阐述了半导体芯片、集成电路器件的封装制造工艺，讲述了微电子器件封装的电子学和热力学设计的基础理论。

本书可以作为从事微电子器件制造的工程技术人员、管理人员、研究和教育工作者的参考书，也可作为微电子专业教材使用。

<<微电子器件封装>>

作者简介

周良知，1965年大学毕业，1982年获硕士学位，1987年，作为访问学者，赴美国斯坦福大学材料科学与工程系进修，之后先后在美国National Semiconductor Corp. Alliance Fiber Optic Products Inc. Oplink Communication Inc. OpticNet Inc.等担任半导体硅晶片工艺师、微电子器件研究与开发工程师、微电子器件封装高级工程师等职务。

<<微电子器件封装>>

书籍目录

1 微电子器件封装概述 1.1 微电子封装的意义 1.1.1 微电子器件封装和互连接的等级 1.1.2 微电子产品 1.2 封装在微电子中的作用 1.2.1 微电子 1.2.2 半导体的性质 1.2.3 微电子元件 1.2.4 集成电路 1.2.5 集成电路IC封装的种类 1.3 微电子整机系统封装 1.3.1 通信工业 1.3.2 汽车系统当中的系统封装 1.3.3 医用电子系统的封装 1.3.4 日用电子产品 1.3.5 微电子机械系统产品 1.4 微电子封装设计2 封装的电设计 2.1 电的基本概念 2.1.1 欧姆定律 2.1.2 趋肤效应 2.1.3 克西霍夫定律 2.1.4 噪声 2.1.5 时间延迟 2.1.6 传输线 2.1.7 线间干扰 2.1.8 电磁波干扰 2.1.9 SPICE电路模拟计算机程序 2.2 封装的信号传送 2.2.1 信号传送性能指标 2.2.2 克西霍夫定律和转变时间延迟 2.3 互连接的传输线理论 2.3.1 一维波动方程 2.3.2 数字晶体管的传输线波 2.3.3 传输线终端的匹配 2.3.4 传输线效应的应用 2.4 互连接线间的干扰(串线) 2.5 电力分配的电感效应 2.5.1 电感效应 2.5.2 有效电感 2.5.3 芯片电路的电感和噪声的关系 2.5.4 输出激励器的电感和噪声的关系 2.5.5 供电的噪声 2.5.6 封装技术对感生电感的影响 2.5.7 设置去耦合电容 2.5.8 电磁干扰 2.5.9 封装的电设计小结3 封装的热控制4 陶瓷封装材料5 聚合物材料封装6 引线框架材料7 金属焊接材料8 高分子环氧树脂9 IC芯片贴装与引线键合10 可靠性设计参考文献

<<微电子器件封装>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>